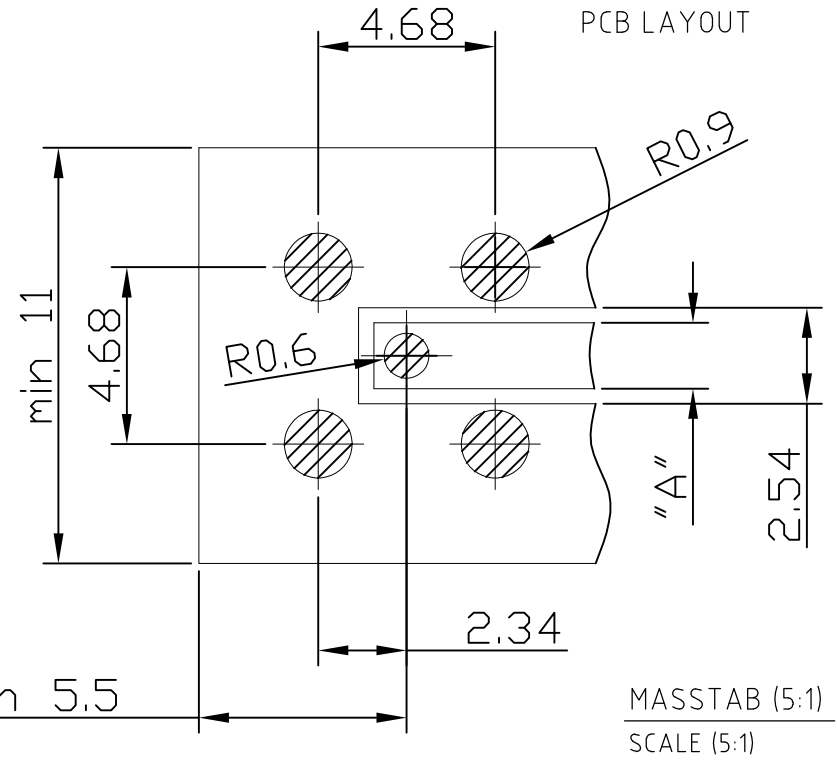
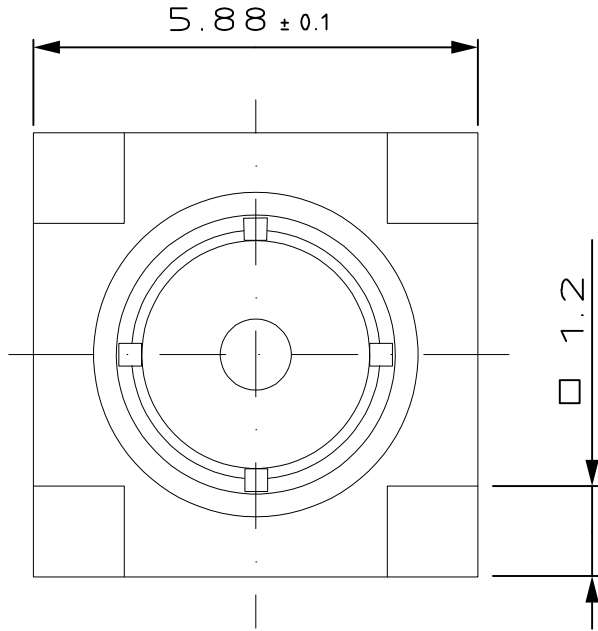


DIM "A"	1.74: PCB MIT MASSE VERBINDUNG AUF DER UNTERSEITE
	2.07: PCB OHNE MASSE AUF DER UNTERSEITE
	1.74: PCB WITH VIA CONNECTION AND GROUND ON THE OTHER SIDE
	2.07: PCB WITHOUT GROUND ON THE OTHER SIDE



VERGOLDET NACH AMP SPEZ. 112-162-5; 0.8µm
MIN. DICKE ÜBER VERNICKELUNG NACH AMP SPEZ.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. DICKE.

GOLD-PL. PER AMP SPEC. 112-162-5; 0.8µm
MIN. THK. OVER Ni-PL. PER AMP SPEC.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.

RECOMMENDED PCB: MATERIAL: FR4
THICKNESS 1.6 mm
DIELECTRIC CONSTANT = 4.8
PLATING: 30µm-70µm Cu

- | | |
|----|---|
| 7 | COAX STECKVERBINDER NACH CECC 22220
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22220 |
| 8 | VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING |
| 9 | SMD-GURTVERPACKUNG NACH IEC 60286-3
SMD-STRIP-PACKAGING ACCORDING TO IEC 60286-3 |
| 10 | EIN KUPPLER IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
ONE JACK PACKED IN PLATIC BAG |

1	1	1	1	4	KUPPLERKÖRPER SHELL	CuZn	
			-	3	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	
			1	2	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	
1	1	1	1	1	ISOLIERSTÜTZE DIELECTRIC	PTFE	
966851-4 	966851-3 	966851-2 	966851-1 	ITEM NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING
					GEZ. 29.11.95 M. STEIN	GEPR. 29.11.95 D. BOZZER	

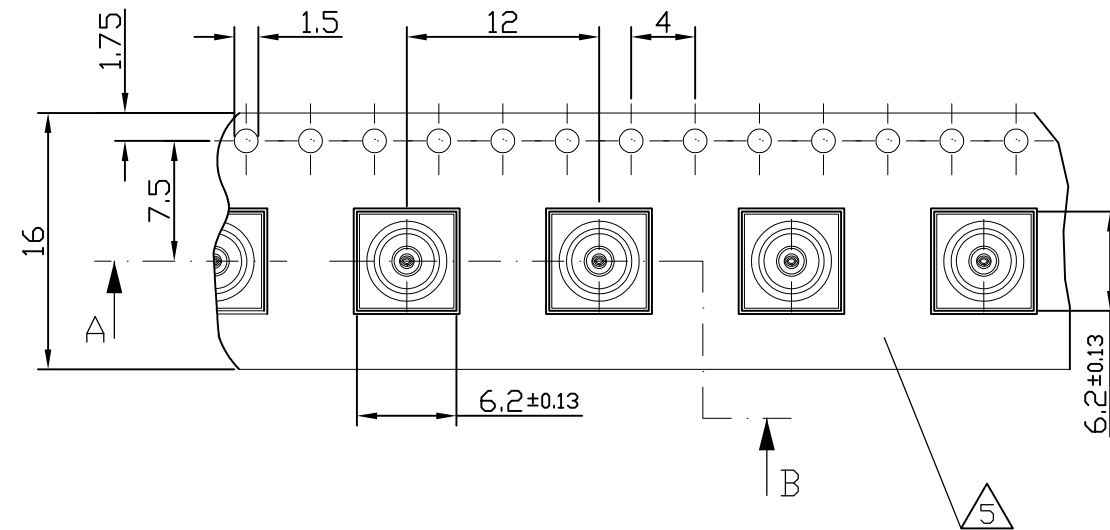
		DSM AN AMP COMPANY St MAURICE, SWITZERLAND	
BENENNUNG/DESCRIPTION COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTENMONTAGE (RASTER 5,08 mm) COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5,08 mm)			
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.5 $\pm -$	FORMAT A3	ZEICHNUNG-NR. 966851	
MASSSTAB/SCALE 10:1	BLATT/SHEET 1	VON 2	REV. E1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

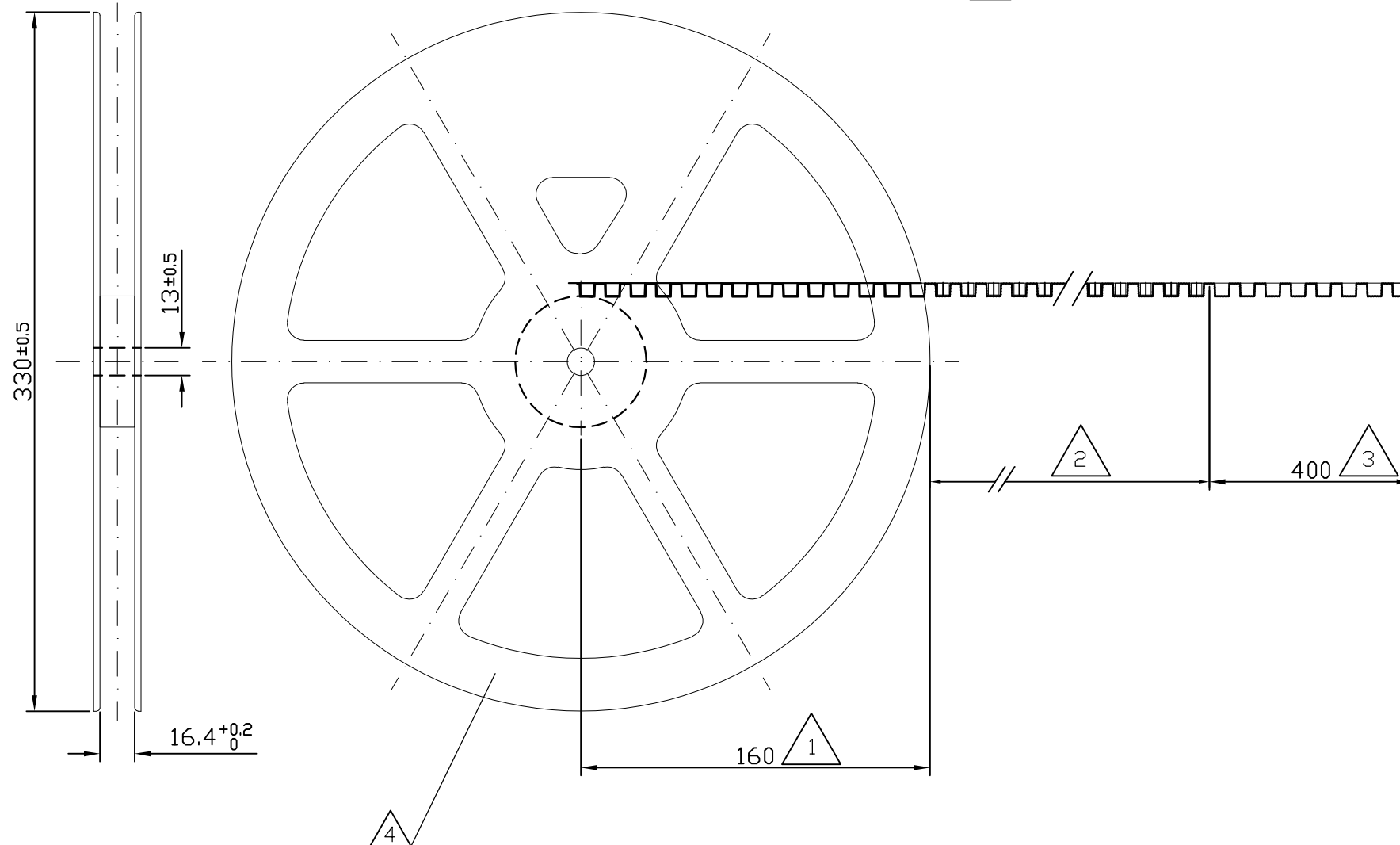
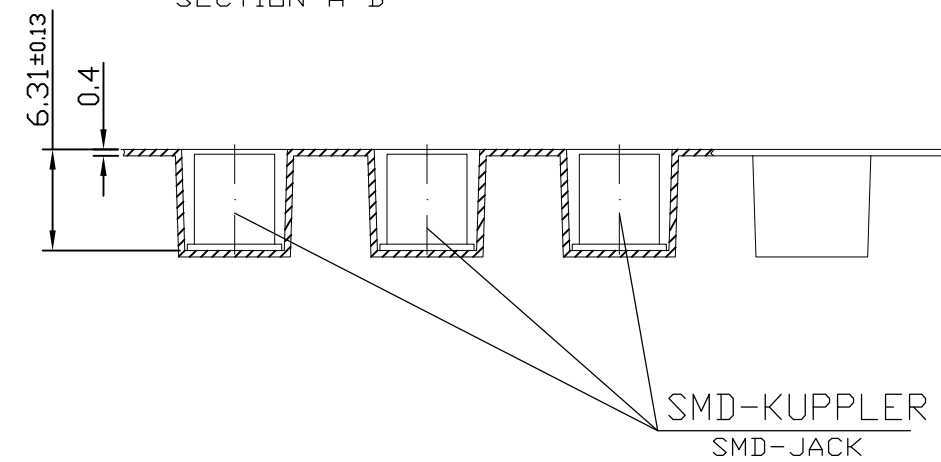
ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

M3:1



SCHNITT A-B
SECTION A-B

M3:1



6 EINHEIT PRO REEL: 800 STK.
UNIT PER REEL: 800 PIECES

 BLISTERGURT NACH IEC 60286-3
BLISTER BELT ACCORDING TO IEC 60286-3

4 AUS POLYSTYREN
MADE FROM POLYSTYRENE


 VORLAUF: MIN.400mm TRÄGERGURT NACH
 IEC 60286-3
(LEER, ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
 OFFSET: MIN.400mm BLISTER BELT ACCORDING TO
 IEC 60286-3 (EMPTY, BUT SEALED WITH
 COVERBELT)

2 BLISTERGURT BESTÜCKT MIT BAUTEILEN
BLISTER BELT FILLED WITH PARTS

① NACHLAUF NACH IEC 60286-3
(LEER ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
LAST RUNNINGS ACCORDING TO IEC 60286-3
(EMPTY, BUT SEALED WITH COVERBELT)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB	15/00
---------------------	-------

AMP

DSM AN AMP COMPANY
ST MAURICE, SWITZERLAND

BENENNUNG	COAXICON® SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTEN-MONTAGE (RASTER 5.08 mm)
-----------	--

COAXICON® SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB
(PITCH 5.08 mm)

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
± 0,5	A2	966851

± -	HL	700051
MASSTAB -	BLATT 3 VON 3	REV. E

-						ZEICHNUNG GÜLTIG AB		15/00			
						 DSM AN AMP COMPANY ST MAURICE, SWITZERLAND					
						BENENNUNG					
						COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTEN-MONTAGE (RASTER 5.08 mm)					
						COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5.08 mm)					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.5 ± -	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 966851			
			GEZ. 29.11.95 M. STEIN	GEPR. 29.11.95 D.Bozzer		MASSTAB -	BLATT 2 VON 2	REV. E1			